

芯联集成电路制造股份有限公司

关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的

半年度评估报告

公司锚定“连结资源、汇聚智慧、持续创新、鼎力支撑全球智慧型新能源革命”的愿景，秉承“创新科技 点亮地球”的使命，积极开展“提质增效重回报”专项行动。2026 年上半年公司全面启动并推进“提质增效重回报”专项行动，各项举措落地见效：积极跟进市场变化，加深与客户合作，客户合作从“单点合作”向“深度绑定”有效转型；以核心技术为锚点驱动创新，提升公司与合作伙伴的市场竞争力；加速新兴赛道业务拓展，夯实长期发展根基；激发组织活力并优化人才配置，传递公司发展信心；夯实规范运作基础，支撑公司长期稳健发展。

一、四大应用领域构筑公司发展基石，报告期内营收、毛利率双升

2026 年上半年，公司敏锐洞察行业需求变化，以客户为中心，持续优化和丰富产品矩阵，不断拓展合作的广度与深度：从单一产品的合作逐步延伸至多品类、多场景的系统性解决方案；通过技术迭代与产品创新，精准匹配下游客户日益多元化的需求，进一步巩固核心客户的合作黏性；同时积极开拓 AI 数据中心等前沿市场，构建更加稳固的客户生态体系。报告期内，公司订单饱满、产能利用率不断攀升，晶圆生产量 148 万片（折合 8 英寸），同比增长 28.86%。报告期内公司营业收入 45.62 亿元，同比增长 30.53%，规模化效应逐步显现，上半年公司毛利率 12.71%，同比提升 9.17 个百分点。

2026 年下半年，公司将继续深耕 AI、车载、工控、高端消费等领域的技术和研发；重构与合作伙伴的底层逻辑，与合作伙伴从单点优化逐步形成全链共振，系统降本增效；共享新产品研发机遇与价值，从被动配套到价值共创。随着 AI 算力基础设施建设的加速推进、智能网联汽车渗透率的持续提升以及物联网终端需求的快速增长，公司产品的市场空间将进一步打开。公司将继续深化产品结构优化策略，加大研发投入，向更高端、更智能、更集成的产品方向迈进，构筑更深厚的竞争护城河。

二、以核心技术为锚点驱动创新，提升公司与合作伙伴的市场竞争力

公司坚持“市场+技术”双轮驱动的发展战略，在 AI 数据中心、人工智能、

新能源等重点发展的战略性新兴产业领域开展前瞻性技术布局,结合自身在特色工艺领域的深厚积累,不断拓展技术边界,持续巩固并强化行业领先的技术研发优势,为未来业务增长注入源源不断的创新动能。公司研发团队汇聚了 1,238 名技术实力深厚、经验丰富的技术精英。在丰富的研发项目和完善的研发体系下,公司研发团队不仅具备前瞻性的技术视野,同时不断提升对现有技术体系的深刻理解和掌控。2026 年上半年公司研发投入 9.05 亿元,继续保持高水平的研发投入。报告期内,公司新增获得发明专利等 74 项,累计已获得发明专利等知识产权 648 项,构成了公司核心竞争力的重要壁垒。

2026 年下半年,公司将继续以核心技术为锚点,以研发驱动创新,以创新驱动公司发展。在战略层面,公司将进一步聚焦 AI 数据中心、人工智能等核心目标,集中优势资源提升关键领域的技术水平,建立清晰的研发战略规划和产品矩阵,精准对应市场需求;在管理体系上,建立跨部门协同,确保产品从需求到最终交付的全链条管理,实现客户需求快速响应与资源高效调配;在效率提升方面,公司将前瞻布局下一代关键技术,持续推出具有市场竞争力的新技术和新产品,驱动公司自身技术创新和产品迭代升级,为客户创造更大的竞争优势,同时提升公司在行业中的领先地位。

三、布局 AI 基建和终端等新兴产业,打开长期成长空间

根据公司长期发展战略规划,加快完善公司在高端模拟集成电路芯片领域的战略布局,增强核心竞争力;抓住当前 AI 数据中心、新能源汽车、机器人、光互连等新兴产业的发展契机,推动公司主营业务持续成长,公司与绍兴市杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会合作,建设一条 5 万片/月的 12 英寸集成电路数模混合芯片生产线,主要技术和产品方向为 40/28 纳米 MCU/DSP、90/55 纳米 BCD/DrMOS 等数字/模拟电路、55 纳米硅光/激光驱动等芯片。项目计划总投资约 200 亿元。其中资本金 120 亿元,芯联集成拟出资 30.12 亿元。该项目的顺利推进,有利于公司切入 AI 基建和终端这一高增长赛道,进一步强化公司在 MEMS、功率、模拟 IC 领域的技术与产能壁垒,补齐国内硅光制造产能短板,深度参与 AI 算力基础设施建设,持续打开长期成长空间。

2026 年下半年公司将持续推进专业化、市场化的产业投资布局,灵活运用股权投资等多元化资本运作方式开展对外投资与合作。通过产业资源整合进一步

完善产品布局与业务结构，加速新兴赛道业务拓展，夯实长期发展根基，助力公司整体价值实现持续、稳步提升。

四、持续推进限制性股票激励计划，传递公司发展信心

2026年上半年公司持续推进与落地执行限制性股票激励计划：2026年3月公司首次授予激励对象完成归属过户；2026年4月与5月，董事会先后审议预留授予部分第一个归属期和首次授予部分第二个归属期的归属条件成就相关议案。公司股权激励计划的积极进展，有效降低了核心人才的流失风险，为公司保留关键技术骨干和管理中坚提供了保障；通过分批次、分阶段的归属安排，激发组织活力，形成了良性循环；推动人力资源向高绩效、高潜力的核心岗位集中，实现人才资源的优化配置。股权激励计划的稳步推进是公司基本面良好的重要佐证，也向市场传递了公司员工对未来发展的坚定信心。

2026年下半年公司将继续推进股权激励计划的执行和落地。同时公司将根据市场情况，在必要的情况下，适时采取相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。在达到分红条件后，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定相应的分红方案，以实质回报投资者。

五、持续披露 ESG 报告，2025 年度获中证 AA 评级

公司始终秉持主动披露原则，持续发布可持续发展报告，以实际行动助力资本市场健康有序发展，推动可持续繁荣。公司已连续多年发布可持续发展报告，在报告编制过程中不断优化内部管理机制与编制流程，着力提升报告的真实性、准确性与可读性。2025年度公司通过可持续发展报告系统呈现了公司在环境、社会及治理各维度的实践成果，全面阐述了相关战略规划与实施成效，向投资者及社会公众完整展示了公司的责任担当与发展历程，充分彰显了公司可持续发展的理念。2025年公司 ESG 报告评级获得中证 AA 评级。

2026年下半年公司将继续推进透明化信息披露，持续巩固与投资者的信任关系，让各方更清晰了解公司经营发展战略，以及公司在环保与社会责任方面的长期坚守。

六、夯实规范运作基础，支撑公司长期稳健发展

2026 年上半年根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》，结合公司生产经营和业务发展情况，公司修订并披露了《募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《套期保值业务管理制度》《委托理财管理制度》。同时为进一步优化公司治理结构，完善高级管理人员配置体系，提升公司经营决策与统筹管理效率，结合公司实际运营及人才储备情况，公司修订了《公司章程》中关于副总经理名额的内容并同步披露了修订后的《公司章程》。

2026 年下半年公司将以治理结构优化为牵引、内控体系完善为抓手、权责制衡为保障、文化培育为根基，深化治理结构建设，夯实规范运作基础；结合行业特点与自身业务实际，持续完善覆盖全业务、全流程、全岗位的内控制度体系，全方位提升公司规范运作水平，切实维护股东及利益相关方的合法权益，为实现公司长期稳健发展提供坚实支撑。

七、其他事宜

公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案的各项举措落地实施，并及时履行信息披露义务。公司将深耕高价值产业链，聚焦主业发展，持续增强核心竞争力、盈利能力和风险管控水平。通过稳健的业绩增长与规范的治理结构，切实回馈投资者信任，积极履行上市公司责任与使命，维护公司在资本市场的良好形象，助力资本市场长期健康稳定发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日